

平成 28 年 10 月 ** 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 151 回研究会 開催通知

日 時： 2016 年 12 月 14 日 (木) 13:00～
場 所： 明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 1 階 多目的室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

テーマ： 「結晶スライシング技術の現状と新技術」
世話人： 佐野 泰久 (大阪大学)、閻 紀旺 (慶應義塾大学)、上殿 明良 (筑波大学)

プログラム：

- 13:00～13:05 開会の挨拶 田島 道夫
13:05～13:10 はじめに 閻 紀旺
13:10～13:50 「ワイヤーソーによる延性モードスライシング技術の現状」
諏訪部 仁 (金沢工業大学)
13:50～14:30 「化学エッチングを利用した半導体結晶の切断技術」
村田 順二 (近畿大学)
14:30～15:10 「SiC の新しいレーザースライシング」
高橋 邦充 (ディスコ)
15:10～15:30 休憩
15:30～16:10 「ワイヤ放電技術を用いたマルチスライシングへの取り組み」
岡本 康寛 (岡山大学)
16:10～16:50 「イオン注入剥離法により作製した貼り合わせ SiC 基板の評価」
河原 孝光 (サイコックス)
16:50～16:55 おわりに 上殿 明良
16:55～17:20 委員総会
17:30～19:30 意見交換会 (明治大学 グローバルフロント 17 階 グローバルラウンジにて)

以上